

4971 **メック**

**前田 和夫** (マエダ カズオ)

メック株式会社社長

**薬品の売上高、出荷量が好調に推移し、増収増益を達成**

#### ◆2018年12月期第3四半期のトピックス

2017年12月期より事業年度の末日を3月31日から12月31日に変更した。これに伴い2017年12月期第3四半期連結財務表を作成していないため、当第3四半期の対前年同四半期増減率は記載していない。

当第3四半期はサーバ、データセンター、自動車は堅調に推移したが、スマートフォンは全体的に停滞気味であった。当期前半は好調に推移した仮想通貨関係は減速した。

為替は想定レートとほぼ同水準で進捗し、実勢レートとの差は大きくはない。米ドルは想定レート113.00円に対して実勢レート109.92円(前年同期112.25円)、台湾ドルは3.70円に対して3.66円(同3.66円)であった。為替の影響は、売上は前年同一期間比63百万円増、営業利益は同31百万円増となった。

薬品は前年同一期間比で売上9.2%増、出荷量は9.1%増である。

当第3四半期は売上高84億32百万円(対同一期間比8.5%増)、営業利益17億47百万円(同4.3%増)、経常利益17億63百万円(同3.8%増)、四半期純利益14億29百万円(同16.0%増)となった。

薬品の売上高は82億84百万円(9.2%増)、売上高に占める割合は98.2%(対前年同一期間比0.5ポイント増)となった。海外売上高比率は54.7%(同0.2ポイント増)となったが、当社薬品海外使用分の国内代理店販売を海外売上高に加算した場合、73.5%になる。CZシリーズは42億22百万円(同11.7%増)となり、対薬品売上高は51.0%(同1.2ポイント増)となった。

粗利率は64.2%(対前年同一期間比0.5ポイント減)となった。設備投資、人員増等を中心に費用面が増加し、売上高増の割には営業利益、経常利益ともに微増となったが、計画の範囲内である。

#### ◆2018年12月期第3四半期決算概要

常務執行役員管理本部長 北村 伸二

当第3四半期は、前年同一期間比で増収増益という結果である。売上高の品種別構成比は、薬品が伸長して98.2%となった結果、売上高は8.5%増となった。

比較連結貸借対照表を見ると、流動資産については、商品および製品、仕掛品、原材料および貯蔵品の棚卸資産は、子会社が活況のため在庫および出荷元の日本の在庫が増加し、2億13百万円増加した。固定資産については、投資有価証券が時価下落により36百万円減少した。その結果、資産合計は195億30百万円(前連結会計年度末比2億82百万円増)となった。

流動負債の1年内返済予定の長期借入金5億円および固定負債の長期借入金5億円は、尼崎事業所建設資金の借入(借入総額20億円)の返済10億円である。流動負債の未払金および未払法人税等は、主に消費税と納税による減少である。純資産の株主資本の資本剰余金、自己株式は、株式報酬制度の会計処理に伴う資本剰余金への振替と端株の買い取りによるものである。

以上の結果、純資産は153億68百万円(7億81百万円増)となり、自己資本比率は78.7%となった。

キャッシュフローについては、現金および現金同等物の期首残高 36 億 64 百万円に対して期末残高は 37 億 45 百万円と、約 80 百万円増加した。

四半期推移を見ると、売上高は第 1 四半期から右肩上がりに推移した。営業利益は商品構成の関係で原材料費の高い商品の出荷増に加え、出荷数量増による運送費の増加を要因として若干利益が減少した。四半期純利益は、補助金収入約 95 百万円増に加えて、台湾の税金還付等の特別利益の増加もあり伸長した。

品種別四半期推移については、その他・資材・機械は減少したが、薬品は増加した。薬品別四半期推移では、その他・剥離剤・フラックス剤・防腐剤はほぼ横ばい、銅表面処理剤が大幅に伸びた。薬品をその他・エッチング剤・密着向上剤で切り分けてみると、エッチング材、密着向上材とも主たる薬品が増えてその他が減少した。出荷数量は、すべての薬品が前期対比で順調に伸びた。

CZ シリーズの主製品である CZ-8100、CZ-8101 の売上高推移を見ると、CZ-8101 だけではなく旧製品の CZ-8100 も自動車関係等に使用されており、微増で推移している。

地域セグメント別売上高推移と海外比率については、日本・アジア・欧州ともに非常に堅調に推移した。

2018 年 12 月期通期連結業績予想は、売上高 116 億円、営業利益 23 億円、経常利益 24 億円、当期純利益 17 億 50 百万円を計画している。なお、商品ミックス、原材料価格、運送費動向等の不透明要素があり、期首予想から据え置きとした。

## ◆今後の事業展開

社長 前田 和夫

「モノからコトへ」とよく言われているが、当社は粗化する、密着性を向上する、サービス、情報、そのための周辺情報や将来の開発情報に取り組んでいる。「サービス化」という非常に漠然とした概念であるが、当社の活躍できる分野は今後ますます拡大するものと期待している。

情報社会からスマート社会へということでは、IoT、AI 活用のためには 5G のネットワークが必要になるが、ネットワーク投資だけではなく、スマート社会を支える音声、画像を中心に民生用から産業用までさまざまなデバイス類に期待している。

現在、PC、サーバ、データセンターが大きく増えて全体の 2 割を占めている。自動車向けが 2 割、テレビ向けが 1 割弱、その他 1 割という構成である。スマートフォン、タブレット PC 向けは最盛期の 5 割近くから約 4 割と、若干減少という感覚である。

CZ シリーズは PC やサーバ、データセンター、自動車に多く出ており、スマートフォン向けは減少している。全体にプロセッサ、センサーは好調に推移しているが、メモリーは調整基調にあり、仮想通貨の影響も考えられる。

自動車は安全走行の場面で伸びているが、自動運転、コネクテッド・カー等通信系の伸展に伴い、当社にとってはこれまで以上の重要な位置づけになるとみており、マーケティング活動でも注力している。

画像を中心としたデバイスは民生用も産業用もあるが、数としては民生用、特にスマートフォン、テレビが重要になり、テレビは 4K、8K、その先ということで 5G 対応の各種場面で比較的堅調に伸展すると見込んでいる。当社のプロセスは COF に広く採用されており、今後、さらに注力する。

PC やサーバ、データセンターは開発的には一番力を入れているが、粗化せずフラットなまま密着強度を上げる技術に磨きをかけており、今後 5G とともに高速、低遅延が求められる中で威力を発揮し、業績の底上げが期待される。

スマートフォンとタブレット PC は、今後さらにさまざまなサービスを取り込めるハイエンドの機種種の創出により、現在の年間 15 億台を超えると見込まれる。一方、現在の高級品に近い物を汎用品として生産する動きが世界中で起こると予測される。複雑な仕様の物を極力簡易で歩どまりのよい生産が求められるので、当社のプロセスが非常に有効になる。

ハイエンドの領域はサーバ、データセンターの技術が使用されるとみており、対応は継続するが、加えて次のボリュームゾーンのスマートフォンへの対応に注力する。HDI基板と呼ばれる高密度のマザーボードは細線化、高密度化が要求され、それを実現する EXE シリーズを推奨している。市場は非常に大きいとみている。

スマートフォンの画像処理のドライブ IC 用のチップは、COG(Chip On Glass)から COF(Chip On Film)へという戦略である。高密度配線パターンを実現する EXE シリーズを適用し、市場を創出する。高品質、低コストで簡単につくことにトライする。それ以外にもマザーボード外装の CZ シリーズ、内装の V ボンド等も取り込むチャンスは十分にあり、当社の業績に貢献させる。

Substrate-Like PCB は、電子基板ではあるけれども半導体のパッケージ基板のような基板ということで、主に HDI 基板、スマートフォンのマザーボードを指す。当社としては、同じ性能が出るのであれば、使い勝手あるいはメーカーの考え方によって、サブトラクティブ法によるパターン形成でもいいと捉えている。

ファンアウト・パッケージについては、アメリカの通信機器メーカーは、メインの CSP に WLP を使用しているが、他のメーカーは特に WLP にこだわっていない。基本的には従来の基板と同じようなつくり方である。

SiP はハイエンドでデータセンター、サーバに使用されるもので、2.5D が中心になって徐々に立ち上がりをみせている。

EXE シリーズは、配線をきれいに形成する当社のコア技術である。粗化する CZ シリーズ、UT シリーズ、V ボンドは物理的に密着させる。選択エッチング、SF はディスプレイ関連に使用されている。

高周波については、スピードが上がり、低遅延であるところにはフラットな処理が使用されている。当社は既に約 4 年の実績があり、今後さらに量産を行う計画である。

ESG については、ESG 投資もあり、会社規模に合わせて取り組んでいる。今後さらに改善に努める。技術マーケティングを大事にしている。オープンイノベーションを推進する。ESG に H(人財の採用・育成・活躍)をプラスして「ESG-H 戦略」を経営の基盤、根幹に置き、日々努力している。

## ◆ 質 疑 応 答 ◆

**前期および前々期比減速の要因は、仮想通貨以外にあるか。また今期以降に影響するのか。**

スマートフォンが伸び悩んだ。今後の予想は難しいが、直近ではそれほど急速な伸長はないとみている。ただ、5G への切り換えにより、チャンスはある。

**EXE シリーズは来年に向けてどの程度の伸びを期待しているのか。**

今後、顧客と具体的な評価に入り、その結果次第である。HDI 向け EXE シリーズは最盛期、アメリカ向けに生産している会社が 1 社あったが、2 億円余だった。国により差異は出るが、潜在的な市場は大きいとみており、ある程度のシェアを取るとそれなりの規模になる。

**来年度も引き続き固定費の上昇が増収効果を吸収する形を想定しているのか。**

大きなウエートを占める人財採用が、当初予定より若干おくれたため、来年度はその分が通年で効くので今年度と同様に固定費を押し上げる。

(2018 年 11 月 19 日・東京)

\* 当日の説明会資料は以下の HP アドレスから見ることができます。

<http://www.mec-co.com/ir/library/>